

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **ASMPT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### **二零二五年全年業績新聞稿**

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止全年業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命  
董事  
黃梓達

香港，二零二六年三月四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



## ASMP T 公布二零二五年全年業績

### 人工智能驅動的結構性增長鞏固集團業績

#### 集團業績概覽

##### 關鍵亮點

- \* 人工智能驅動集團提高新增訂單總額及銷售收入
- \* TCB 勢頭鞏固邏輯和記憶體的技术領導地位
- \* 人工智能伺服器及中國電動車需求驅動 SMT 錄得強勁新增訂單總額
- \* 轉型措施將專注於後工序封裝業務

##### 集團財務概要

(港幣百萬元)	二零二五年 第四季度	按季	按年	二零二五年	按年
	<b>持續及終止<sup>1</sup>經營業務</b>				
新增訂單總額	4,254.3 (5.47 億美元)	+17.5%	+30.5%	14,982.9 (19.2 億美元)	+17.5%
銷售收入	4,333.5 (5.57 億美元)	+18.4%	+27.3%	14,521.0 (18.6 億美元)	+9.8%
毛利率	36.5%	+88 點子	-65 點子	38.0%	-198 點子
經營利潤	234.7	+365.0%	+>45x	614.5	+10.1%
盈利	953.6	NM	+>220x	901.9	+163.6%
每股基本盈利	港幣 2.30 元	NM	+>220x	港幣 2.17 元	+161.4%
	<b>持續及終止<sup>1</sup>經營業務之非香港財務報告會計準則計量<sup>2</sup></b>				
經調整毛利率	36.5%	-114 點子	-65 點子	38.5%	-147 點子
經調整經營利潤	234.7	+88.8%	+>45x	688.4	+23.3%
經調整盈利	181.3	+77.9%	+121.3%	501.4	+17.7%
經調整每股基本盈利	港幣 0.44 元	+83.3%	+120.0%	港幣 1.20 元	+15.4%

NM: 無意義

(港幣百萬元)	二零二五年 第四季度	按季	按年	二零二五年	按年
	<b>持續經營業務</b>				
新增訂單總額	3,886.6 (5.00 億美元)	+5.0%	+28.2%	14,477.8 (18.6 億美元)	+21.7%
銷售收入	3,959.0 (5.09 億美元)	+12.2%	+30.9%	13,736.2 (17.6 億美元)	+10.0%
毛利率	35.8%	+35 點子	-101 點子	37.8%	-226 點子
經營利潤	161.0	+99.8%	NM	625.5	+8.8%
盈利	1,109.6	NM	NM	1,084.7	+272.7%
每股基本盈利	港幣 2.67 元	NM	NM	港幣 2.61 元	+267.6%
	<b>持續經營業務之非香港財務報告會計準則計量<sup>2</sup></b>				
經調整毛利率	35.8%	-175 點子	-101 點子	38.3%	-172 點子
經調整經營利潤	161.0	+4.3%	NM	699.4	+21.7%
經調整盈利	119.9	+42.2%	+390.7%	466.7	+24.5%
經調整每股基本盈利	港幣 0.30 元	+50.0%	+400.0%	港幣 1.12 元	+23.1%

NM: 無意義

(港幣百萬元)	二零二五年 第四季度	按季	按年	二零二五年	按年
	<b>終止經營業務</b>				
盈利/ (虧損)	(155.9)	NM	NM	(182.8)	NM
經調整盈利 (非香港財務報告會計準則 計量 <sup>2</sup> )	61.4	+249.1%	+6.9%	34.6	-32.3%

NM: 無意義

### 二零二六年第一季度銷售收入預測

★ 將介乎 4.7 億美元至 5.3 億美元之間，以其中位數計按季-1.8%，按年+29.5%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於

<https://www.asmpt.com/en/investor-relations/financial-information/>

- 1 集團決定出售 ASMPT NEXX, Inc. (「NEXX」)，其被列作終止經營業務。截至集團二零二五年第四季業績公告發布日，尚未就擬議之資產出售達成任何具約束力的協議。進一步更新將按適用的披露責任之要求提供。
- 2 有關上述非香港財務報告會計準則計量之詳情，請參閱集團二零二五年第四季業績公告之「香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬」一節。

(二零二六年三月四日，香港訊) — ASMPT Limited (「ASMPT」 / 「集團」 / 「公司」) (股份代號：0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬件和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績。於二零二五年，集團的先進封裝（「AP」）解決方案勢頭強勁，熱壓焊接（「TCB」）銷售收入創新高並接獲重大新訂單，加強其在邏輯和記憶體市場的領導地位。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「於二零二五年，半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部均受益於人工智能應用和基礎設施投資增加，ASMPT錄得更強勁的新增訂單總額及銷售收入。TCB持續保持強勢頭，而表面貼裝技術解決方案分部亦受惠於人工智能伺服器及中國電動車需求，錄得強勁的新增訂單總額。憑藉我們在先進封裝的技術領導地位，以及對研發及能力的持續投資，我們相信人工智能需求將繼續驅動二零二六年及未來的銷售收入增長。」

除另外說明，以下回顧將僅包括對集團根據非香港財務報告會計準則計量經調整後的持續經營業務。

## 集團二零二五年摘要

於二零二五年，人工智能驅動的結構性行業增長鞏固集團的業績表現，先進封裝和主流業務應用需求強勁。集團的先進封裝業務在 TCB 解決方案帶領下，創銷售收入新高，鞏固其在邏輯和記憶體市場的領導地位。受人工智能伺服器需求及中國電動車領域推動，表面貼裝技術解決方案分部新增訂單總額顯著上升。

- 全年銷售收入為港幣 137.4 億元 (17.6 億美元)，按年上升 10.0%。在 TCB 的推動下，半導體解決方案分部的銷售收入錄得按年 21.8% 的強勁增長，而表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入則按年輕微下降。
- 集團的新增訂單總額按年增長 21.7% 至港幣 144.8 億元 (18.6 億美元)。表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額按年大幅增長 40.0%，半導體解決方案分部的新增訂單總額亦按年增長 6.3%。
- 集團的未完成訂單總額於年底達港幣 61.7 億元 (7.93 億美元)，訂單對付運比率為 1.05，屬二零二一年以來最高水平。
- 集團的經調整毛利率按年下降 172 點子至 38.3%，主要由半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部的毛利率下跌所致。
- 經調整盈利為港幣 4.67 億元，由於經營利潤增加而按年增長 24.5%。
- 資產負債表保持穩健，於二零二五年底錄得強勁的現金及銀行存款達港幣 56.8 億元。於二零二五年底，淨現金為港幣 32.8 億元。
- 董事會建議向股東派發末期股息每股港幣 0.34 元及特別股息每股港幣 0.79 元，於二零二五年度全年合計每股派息為港幣 1.39 元。

## 先進封裝 - 受 TCB 所推動

集團先進封裝業務錄得銷售收入 5.32 億美元，按年增長 30.2%，其中 TCB 解決方案的貢獻最為顯著。

**TCB**：於二零二五年，集團繼續保持 TCB 市場的領導地位，銷售收入創新高，按年增長約 146%。集團修訂了對 TCB 的總潛在市場（「TAM」）的預計，從二零二五年的約 7.6 億美元擴大至二零二八年的 16 億美元，年均複合增長率達 30%。由於全球對人工智能技術的投資增加，及先進邏輯和高頻寬記憶體（「HBM」）應用的預期增長，故今年的預測顯著高於去年。憑藉集團的行業領先技術以及與廣泛人工智能客戶群的深入合作，集團繼續以 35%至 40%的 TCB 市場佔有率為目標。

在邏輯方面，集團進一步加強其在 TCB 晶片到基底（「C2S」）作為工藝標準（「POR」）方面的主導地位，踏入二零二六年第一季度來自外判半導體裝嵌及測試企業的訂單持續流入。隨著市場轉向採用更大的複合固晶，集團已做好準備獲得更多訂單。在晶片到晶圓（「C2W」）方面，其配備的等離子主動去除氧化（「AOR」）專有技術的超微間距 TCB 解決方案，在二零二六年第一季度贏得來自一家領先先進邏輯客戶的多台設備訂單。隨著行業從覆晶回流焊接技術轉型至 TCB，集團作為配備等離子技術的首選晶片到晶圓解決方案供應商，將顯著受益。

在記憶體方面，集團深化與多家客戶的合作關係，並於二零二五年第四季度交付，取得可觀的市場佔有率。集團用於 12 層 HBM4 的 TCB 解決方案在同行中率先接獲多家企業的訂單，確立集團在行業向 HBM4 轉型過程中的領先地位。此外，集團正引領 16 層 HBM4 技術的開發，其基於助焊劑的 TCB 工具已在進行採樣測試，而主動去除氧化免助焊劑工藝則正在進行資格認證。

**混合式焊接（「HB」）**：集團於二零二五年獲得客戶正式驗收，並交付更多工具。集團持續推進其第二代混合式焊接平台的開發，該平台在精確對正、焊接準確度、生產布局效率、每小時產量（「UPH」）方面具競爭力。

**光子**：受人工智能企業對更高頻寬及更快傳輸速度的光學收發器需求所驅動，集團的光子解決方案錄得銷售收入按年增長10%。集團保持800G光學收發器市場的主導地位，同時繼續積極與行業內企業合作開發新一代1.6T收發器解決方案。

**表面貼裝技術解決方案分部**：表面貼裝技術解決方案分部的先進封裝解決方案需求增長強勁，獲得大量系統封裝（「SiP」）訂單，按年增長約 43%。其中，人工智能推動的系統封裝需求在基站射頻模組領域需求尤為殷切。此外，集團新一代晶片裝嵌工具在先進邏輯智能手機應用領域獲得客戶青睞。

## 主流業務 - 人工智能驅動強勁需求

於二零二五年，人工智能需求驅動集團主流業務勢頭強勁。由於對人工智能數據中心能源管理需求不斷上升，使全球領先整合設備製造商的產能利用率持續高企，半導體解決方案分部的主流業務因而受支持。同時，表面貼裝技術解決方案分部贏得更多訂單，以支持基站日益增長的數據傳輸需求。

在中國市場，集團半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部的主流業務方面的銷售收入均錄得按年約18%的增長。半導體解決方案分部的增長受惠於外判半導體裝嵌及測試商的產能利用率強勁，帶動焊線機及固晶機應用需求的增長。於二零二五年，表面貼裝技術解決方案分部的增長則主要受惠於數據中心人工智能伺服器主機板普及應用，及中國對電動汽車的強勁需求所推動。

## 集團二零二五年第四季度摘要

- 銷售收入為港幣 43.3 億元 (5.57 億美元)，包括持續經營業務及終止經營業務，較集團銷售收入預測的上限更高。
- 銷售收入按季增長 12.2%，按年亦增長 30.9%，由半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部的強勁銷售收入增長所推動。
- 集團的新增訂單總額為港幣 38.9 億元 (5.00 億美元)，按季增長 5.0%，按年亦增長 28.2%，新增訂單總額按季增加主要由於半導體解決方案分部的 TCB 新增訂單增加；而按年增長則主要由表面貼裝技術解決方案分部的主流業務推動。
- 經調整毛利率為 35.8%，按季下降 175 點子，按年亦下降 101 點子。
- 經調整經營利潤為港幣 1.61 億元，按季增長 4.3%，是由於銷售收入增加及經營槓桿效應。
- 經調整盈利為港幣 1.20 億元，按季增長 42.2%，按年亦增長 390.7%，按季增長主要由於集團就訂單取消而收取的費用，而按年增長則反映了經營利潤增加。

## 出售 ASMPT NEXX 的決定

集團已決定出售 ASMPT NEXX, Inc. (「NEXX」)，其於財務報告中已被列作終止經營業務。出售將令集團更專注於後工序封裝業務。集團相信，能持續投資及締造營運協同效益的新擁有人將更有利 NEXX 長遠發展。同時，NEXX 將繼續正常營運，並繼續致力為其客戶提供一流的產品和服務。

## 前景

集團預計二零二六年第一季度的銷售收入將介乎 4.7 億美元至 5.3 億美元之間，以其中位數計按季下跌 1.8%，按年則增長 29.5%。以中位數計算，集團的二零二六年第一季度銷售收入預測（僅持續經營業務）已高於目前市場預期<sup>3</sup>。集團預計半導體解決方案分部將繼續錄得按季增長，主要由 TCB 及高端固晶機所推動，但被表面貼裝技術解決方案分部的季節性因素所抵

<sup>3</sup> 市場預期包括持續經營業務及終止經營業務。

銷。銷售收入按年增長主要由表面貼裝技術解決方案分部的強勁勢頭及半導體解決方案分部的穩定增長所推動。

集團預計於二零二六年第一季度的毛利率將有所改善，主要由於 TCB 和高端固晶機的銷量增加推動半導體解決方案分部的毛利率重回 40% 中位數水平。然而，由於汽車及工業終端市場持續疲弱，表面貼裝技術解決方案分部毛利率將維持於相若水平。

在兩大業務分部的共同支撐下，集團新增訂單總額的勢頭將於二零二六年第一季度有所加速。展望二零二六年，人工智能需求帶來的結構性行業增長預計將會推動半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入增長。憑藉領先行業的技術及與廣泛人工智能客戶群的深入合作，集團對能在高增長市場擴展其 TCB 業務充滿信心。半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部的主流業務繼續受投資全球人工智能基礎設施及中國的穩定需求支持，而表面貼裝技術解決方案分部的汽車及工業終端市場預計短期內仍然疲弱。

## **關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)**

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是香港交易所科技100指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁[www.asmpt.com](http://www.asmpt.com)。

## **前瞻性聲明**

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻性聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，多種因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻性聲明，而 ASMPT 不會承擔任何義務公開地更新或修訂任何前瞻性聲明。除下文另有提及外，本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)

企業傳訊總監

電話：+65 6450 1445

電郵：[eg.lim@asmpt.com](mailto:eg.lim@asmpt.com)

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 / 梁頌欣 / 沈吉

電話：+852 2864 4812 / 2864 4862 / 2864 4870

傳真：+852 2527 1196

電郵：[mandy.go@sprg.com.hk](mailto:mandy.go@sprg.com.hk) / [vivienne.leung@sprg.com.hk](mailto:vivienne.leung@sprg.com.hk) / [angela.shen@sprg.com.hk](mailto:angela.shen@sprg.com.hk)